

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本公司将截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 484,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 38,776,000.00 元（含税），余额为人民币 445,924,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户	开立日期	开立日存放募集资金金额	账户状态	截至 2023 年 3 月 31 日止余额
中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	2020/08/06		存续	52,503,977.72
中国银行股份有限公司重庆水土支行	111674531230	2021/03/29		存续	28,939,497.13
中国银行股份有限公司重庆水土支行	113074526840	2021/03/31		存续	7,220,626.07
东莞银行股份有限公司合肥分行	568000012900396	2020/08/03		已于 2021-12-16 注销	
中国建设银行重庆两江分行	50050104360000002612	2020/07/29		已于 2021-12-17 注销	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100100293125	2020/07/09	164,000,000.00	已于 2021-12-30 注销	
华夏银行北京亦庄支行	10291000002316900	2020/07/09	141,924,000.00	已于 2022-01-26 注销	
华夏银行合肥经济技术开发区支行	14756000000246035	2020/07/13	140,000,000.00	已于 2021-12-21 注销	
中国建设银行股份有限公司郟都支行	51050159720800004091	2020/11/04		存续	
合计			<u>445,924,000.00</u>		<u>88,664,100.92</u>

1：银行账号为 51050159720800004091 的中国建设银行股份有限公司郟都支行系为全资子公司成都

拓维高科光电科技有限公司投资项目有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目设立，2021年4月公司将原项目变更为“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”，该账户资金已全部转出，目前转为一般存款账户使用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

前期募集资金使用情况详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2021年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司2021年3月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途公告》及相关公告：公司决定将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金140,920,398.41元（其中本金140,000,000元利息920,398.41元）用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。截止2023年3月31日，重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目累计投入5,194.22万元，重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目累计投入5,562.97万元。

变更后项目资金使用情况见附件1。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五） 尚未使用的前次募集资金情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，累计已使用募集资金 36,138.30 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 886.31 万元，由于募投项目均尚未完工，本公司尚未使用前次募集资金结余 8,866.41 万元，占前次募集资金总额的 18.29%。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》：受行业周期性以及宏观经济环境影响，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司重新调整项目建设规划，适当放缓了项目的实施进度，将项目预计达到可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月 31 日。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

募投项目“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”、“补充流动资金”无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

募投项目尚在建设期，尚未达到能实现承诺收益的条件。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会
2023年5月16日

附件 1

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 3 月 31 日

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：484,700,000.00						已累计使用募集资金总额：361,382,956.91				
募集资金净额：441,183,962.27						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：140,920,398.41						2020年使用：161,708,080.97				
变更用途的募集资金总额比例：29.07%						2021年使用：73,439,589.88				
						2022年使用：94,794,893.82				
						2023年1-3月使用：31,440,392.24				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1	背光源智能制 造及相关配套 设施建设项目	背光源智能制 造及相关配套 设施建设项目	141,924,000.00	141,924,000.00	94,275,443.89	141,924,000.00	141,924,000.00	94,275,443.89	-47,648,556.11	2023-12-31

2	有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目	重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	140,920,398.41	80,000,000.00	51,942,160.11	140,920,398.41	80,000,000.00	51,942,160.11	-28,057,839.89	2023-12-31
		重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目		60,920,398.41 （注）	55,629,717.67		60,920,398.41 （注）	55,629,717.67	-5,290,680.74	2023-12-31
3	补充流动资金	补充流动资金	159,259,962.27	159,259,962.27	159,535,635.24	159,259,962.27	159,259,962.27	159,535,635.24	275,672.97	
合计			442,104,360.68	442,104,360.68	361,382,956.91	442,104,360.68	442,104,360.68	361,382,956.91	-80,721,403.77	

注：公司于2021年3月26日召开第三届董事会2021年第八次会议及第三届监事会2021年第五次会议，于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至2021年2月28日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金140,920,398.41元（其中本金140,000,000元，利息920,398.41元）。变更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。

附件 2

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 3 月 31 日

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效 益 (年新 增利润总额)	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022	2023 年 1-3 月		
1	背光源智能制造及相关配套设施建设项目	不适用	3,758.68	建设期	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
2	重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	不适用	9,914.43	建设期	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
3	重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	不适用	不适用	/	/	/	建设期	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	/	/	/	/	不适用	不适用
合计		—	—	—	—	—	—	—	—

注 1：截至 2023 年 3 月 31 日，募投项目“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”、“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”尚在建设中，暂未产生实际效益。

注 2：募投项目“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”、“补充流动资金”不涉及效益测算。